

2007年3月期中間決算説明会

2006年11月21日

株式会社ホロン

JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

INDEX

1. 2007年3月期中間決算の概要
2. 2007年3月期の業績見通し及び課題と対応
3. 新製品EBLITHOについて

1.2007年3月期中間決算の概要

中間期損益(対予想比)

(単位:百万円)

	予想	06年9月期	対予想比	
	金額	金額	増減額	増減比(%)
売上高	105	105	0	0.0%
経常利益	270	260	10	3.7%
中間純利益	274	265	9	3.3%

予想:平成18年10月10日に公表した修正数値を使用しております。

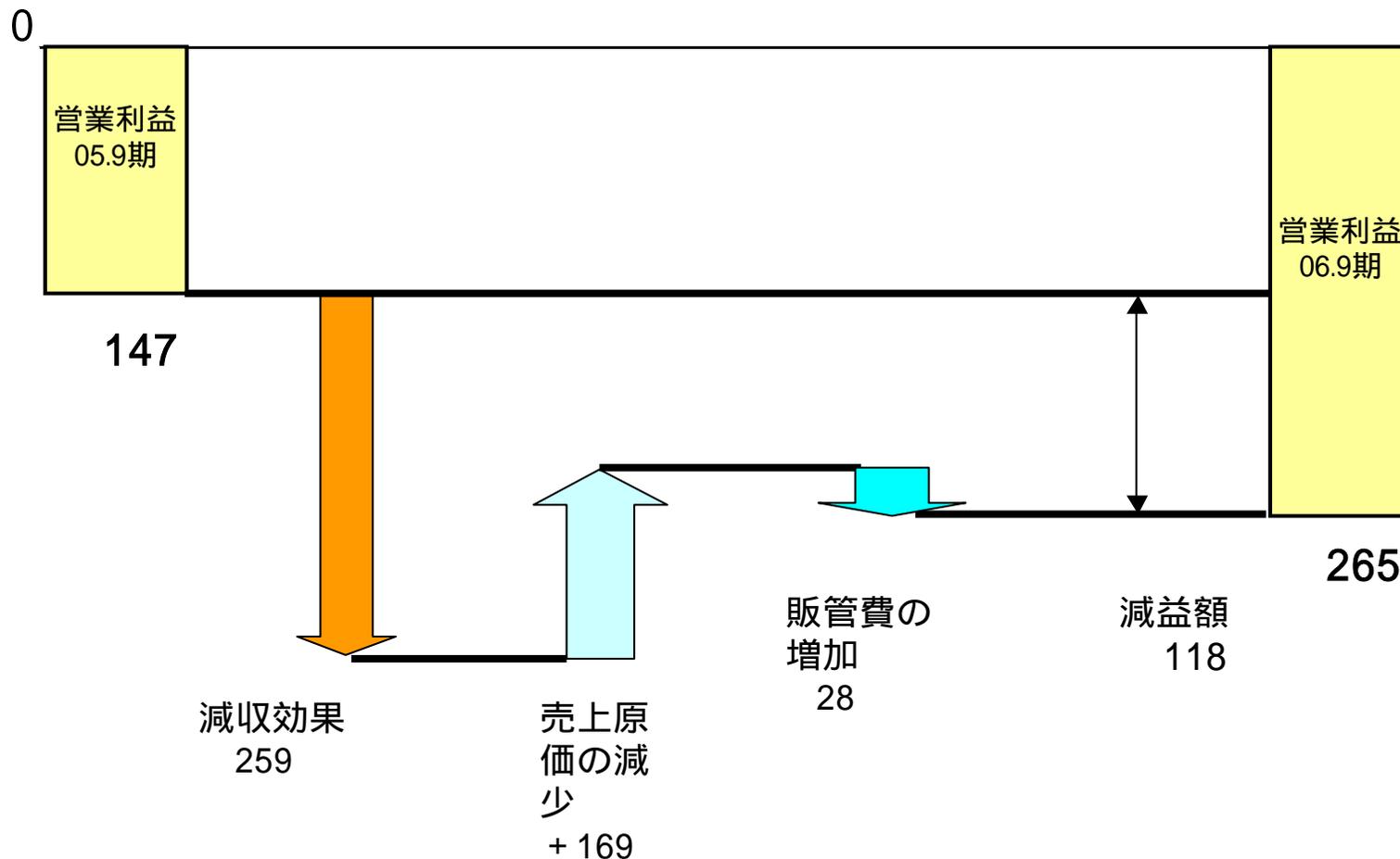
中間期損益(対前期比)

(単位:百万円)

	05年9月期		06年9月期		対前年同期比	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)	増減額	増減比(%)
売上高	364	100.0%	105	100.0%	259	-71.1%
売上総利益	133	36.6%	43	41.6%	90	-67.7%
販管費及び一般管理費	280	77.0%	308	293.2%	28	10.0%
営業利益	147	-40.4%	265	-251.6%	118	80.3%
経常利益	142	-39.1%	260	-247.4%	118	83.1%
中間純利益	86	-23.8%	265	-251.5%	179	208.1%

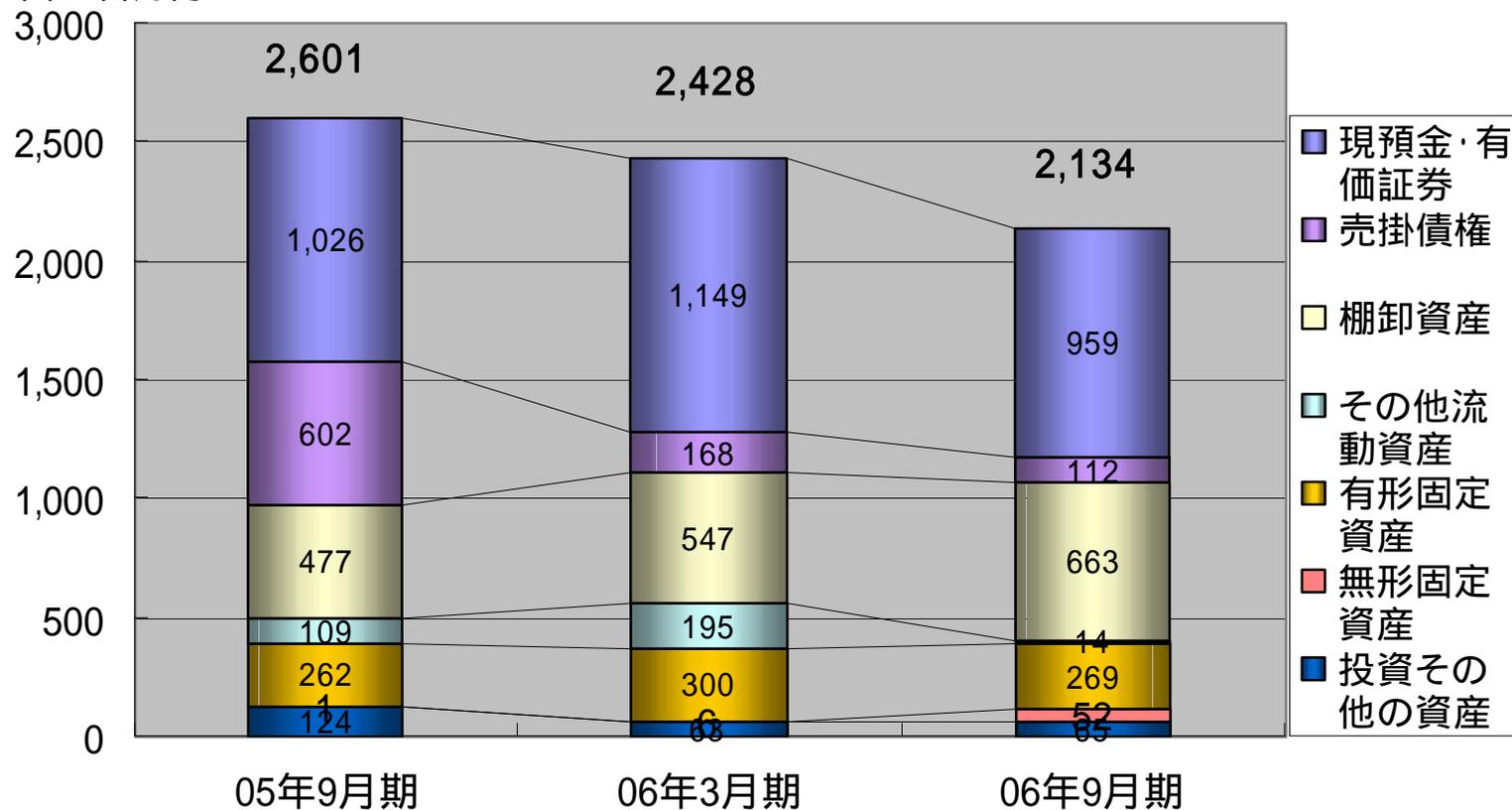
中間期営業利益

単位：百万円

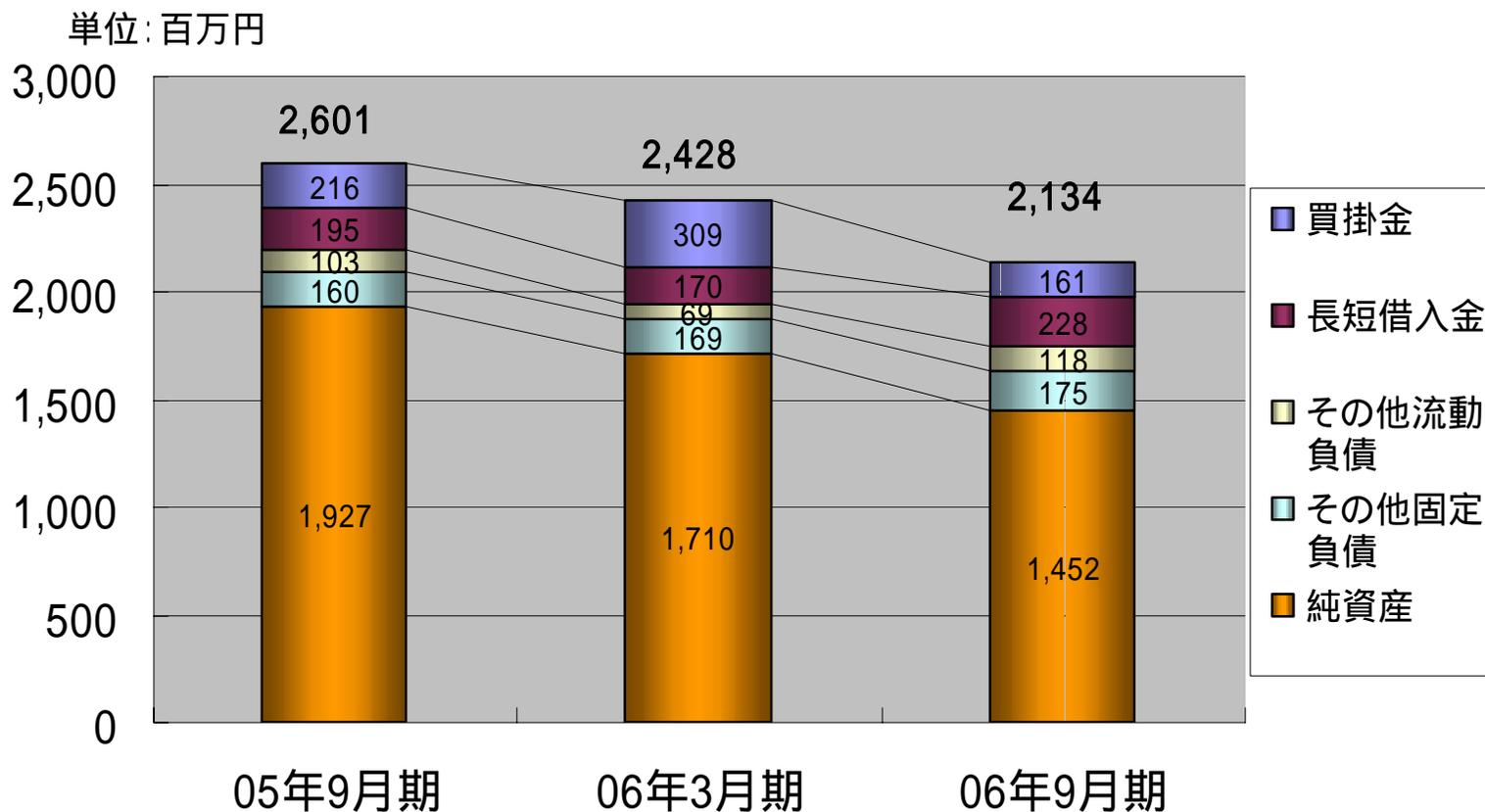


資産の状況

単位：百万円



負債・資本の状況



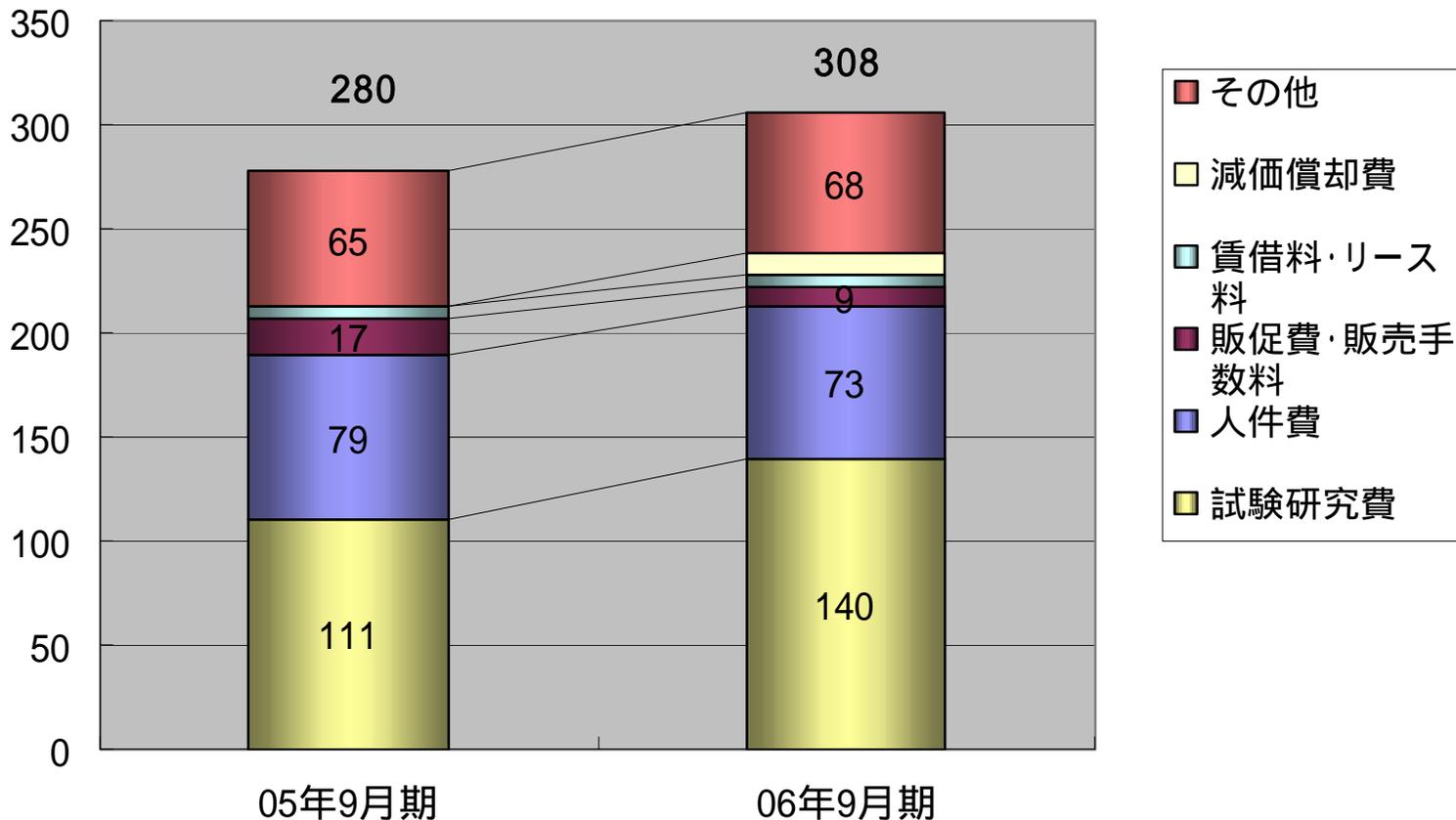
キャッシュフローの状況

(単位:百万円)

	05年9月期	06年9月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	280	220	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	116	34	81
財務活動によるキャッシュ・フロー	72	64	137
現金及び現金同等物の増加額	469	189	279
現金及び現金同等物の中間期末残高	926	959	32

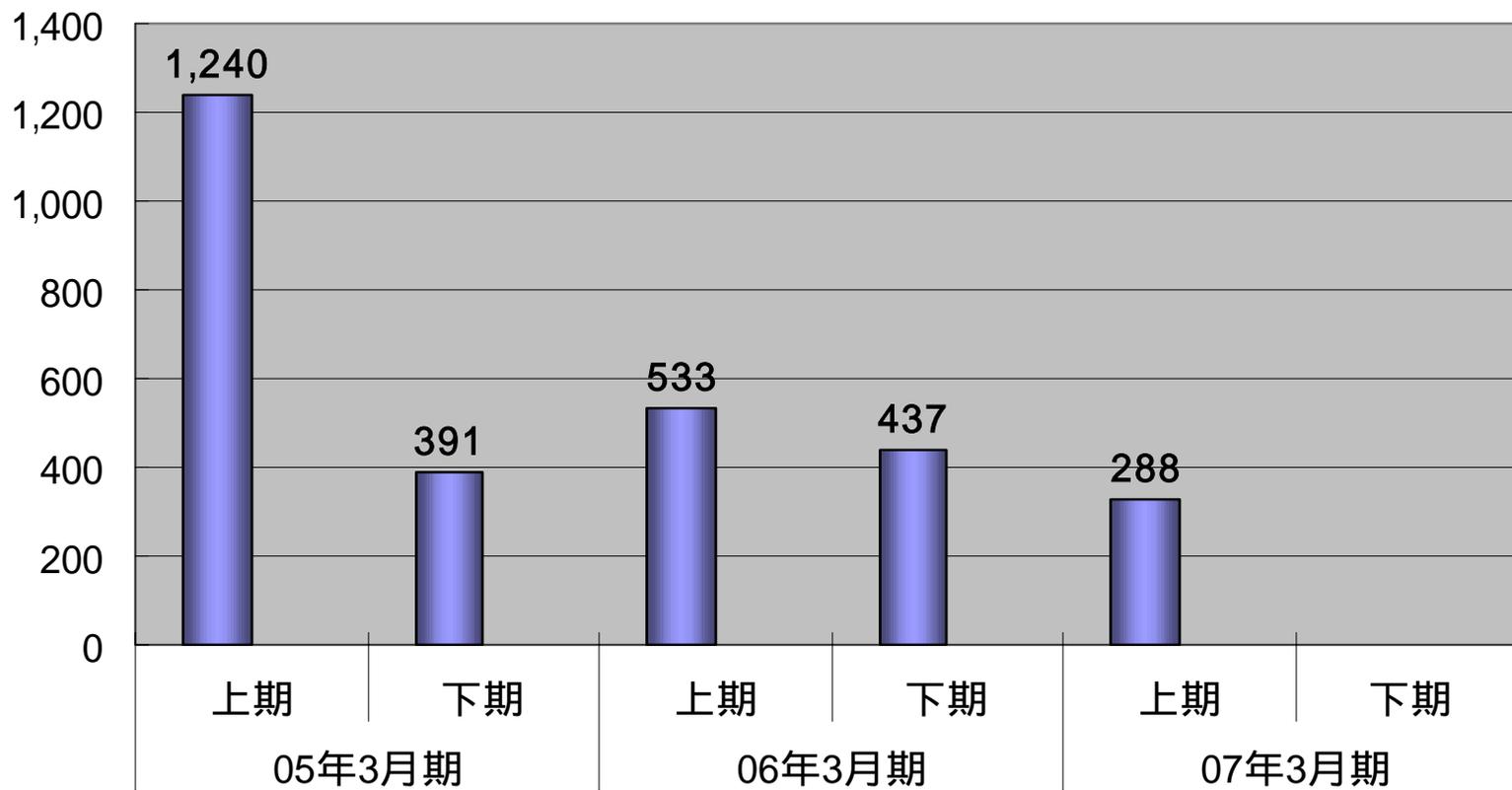
販管費の状況

単位：百万円



受注高の状況

単位:百万円



2.2007年3月期業績見通し及 び課題と対応

業績見通し

(単位:百万円)

	前期実績	07/3期予想	増減額	増減率	06/9期
売上高	974	1,520	546	56.1%	105
経常利益	143	76	219	-	260
(売上高比)	-	5.0%			-
当期純利益	260	74	334	-	265
(売上高比)	-	4.9%			-

今後の課題と対応

1. 当社の今後の成長戦略

(1) EMU

45nm対応機に注力

(2) DIS-05

販売実績の確保

(3) EBLITHO

新たな事業領域への進出

2. 業績変動の抑制

3.新製品EBLITHOについて

微細パターン高速転写装置



低電圧電子ビームとステンシルマスクを利用

高輝度LED製造プロセス向け

EBLITHO

HOLON¹⁶

高輝度LEDのキーテクノロジー

フォトリソニック結晶構造による
発光効率アップ

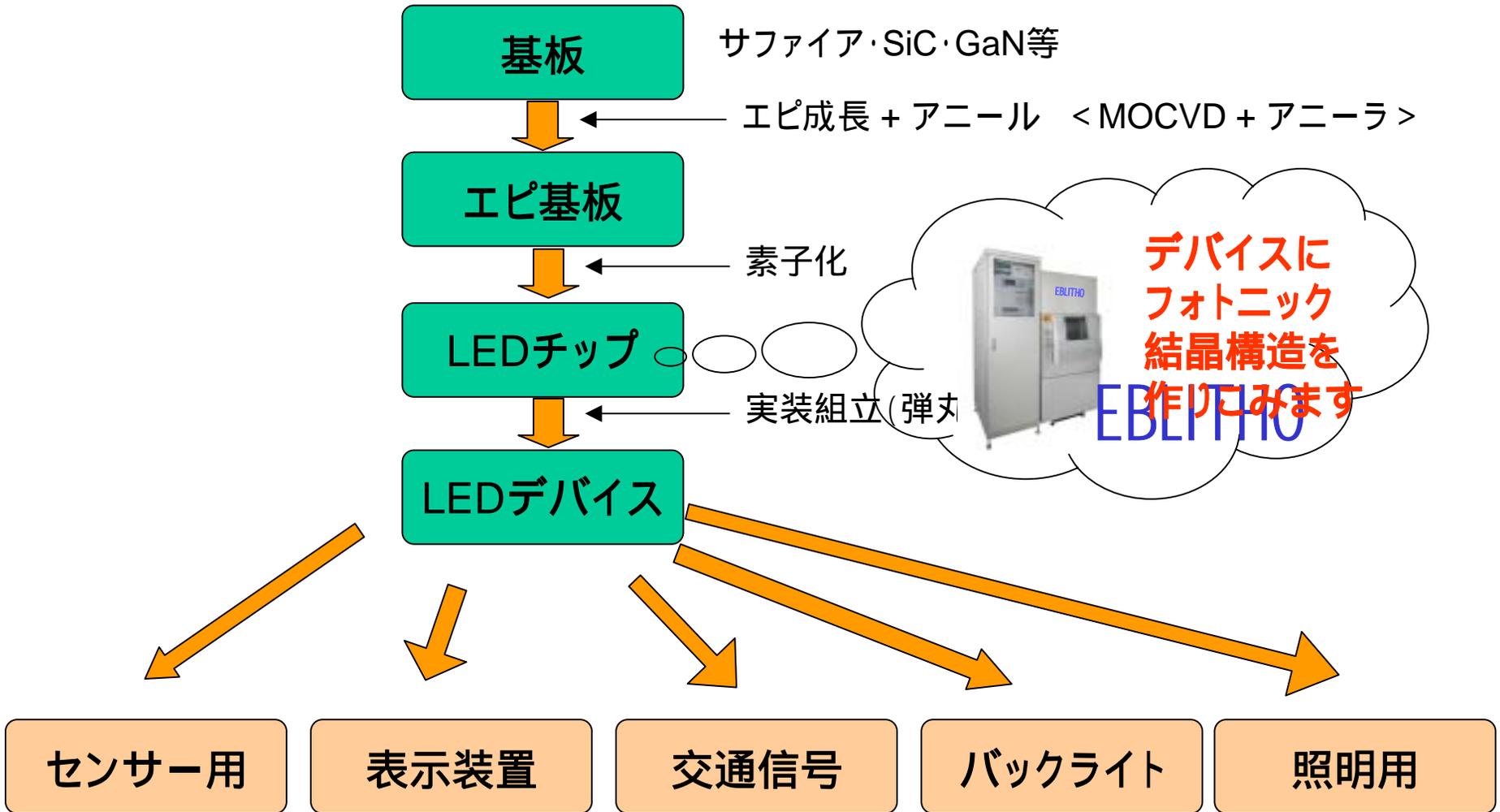
x5.0k 0026 15kV 10μm

LEDの特長

- 省エネ …… 表示用(交通信号機等)
照明用(現在、蛍光灯には輝度で及ばず)
- 長寿命 …… 半永久的
メンテナンス不要
- 小型化 …… 省スペース
新たな照明としての応用
- エコロジー …… 蛍光灯に含まれる『水銀』等、有害物質を含まない
地球環境に優しい

3.新製品EBLITHOにつ
いて

LEDの製造プロセス



電子スタンパー EBLITHO の競合技術比較

	EBLITHO	E B 直接描画 (セルプロ)	ArF ステッパー	ナノインプリント
メーカー	ホロン	A社	B社	C社
価格(円)	1.5億	4~10億	25億	0.5~2億
スループット	5~6枚/時	0.5枚/日	ウェハの平坦化がされないと小面積ショットとなる	2枚/時 熱硬化プロセスに約30分
特徴 (基板の反り)	対応済み	不可	不可	不可 加圧により結晶基板を破損
その他	ステンシルマスクの採用により、周期構造(パターン間の間隔)が正確	PG(パターン発生機構)によりプログラムを組むため正確。 結晶基盤の「反り」により、パターン周期構造は不正確。 パタンがレジスト厚みに対して傾斜して形成されるため、パターンサイズの制御性が困難となる	フォトマスクの正確さにより、パターン周期構造の正確さは問題ない。 真空チャックの為、結晶基板が破損。 焦点深度が浅いため、ウェハ周辺でのパタン形成が困難。	原版(金型)の品質による。 結晶基盤の「反り」により、パターン周期構造は不正確。 金型寿命が短い(500回)

NEW

EBLITHO

3.新製品EBLITHOについて

微細加工をより身近に…
電子スタンパー



- ステンシルマスクと電子線からなる電子スタンパー「EBLITHO」で従来不可能であった生産性と微細性を満たすフォトニック結晶構造が得られます。
- フォトニック結晶構造を素子表面に形成することにより、光取り出し効率が約2～3倍(対未形成素子)の高輝度LED生産が期待されます。
- EB-Stamper called “EBLITHO” composing of the stencil mask and EB, enables to create the perfect periodic structure that meets the requirement of productivity and fineness which the conventional tools can not afford to do so.
- The creation of the perfect periodic structure on the element surface makes it possible to produce high brightness LED's of approx. 2 or 3-fold light generation efficiency (vs. unprocessed element).

- 10mm に敷き詰められた微細パターン(例えば200nmのHole)を1ショット約10秒で転写できます。
- 2” 基板に対応できます。
- 200 μ mの基板反りにも対応可能なステージ(Option)を準備しています。

Hole diameter : 200nm / Pitch size : 300nm

高輝度
LED用

5.0k 0026 15kV 10 μ m

本仕様は、予告なく変更する場合があります。
Note: Specifications may change without prior notice.

HOLON

Solutions for Mask & Wafer Metrology

業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に株式会社ホロンが将来の見直しを見直すとは限りません。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準ですが、新製品等の一部については検収基準により売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。